

ガラスへの高密着めっきプロセス TOPRIZINGプロセス

- 浸漬処理で金属酸化物層が得られる
- 微細パターン形成が可能で耐マイグレーション性が高い

処理工程

脱脂(超音波)

触媒付与

金属酸化物層成膜

熱処理

触媒付与

無電解銅めっき

熱処理

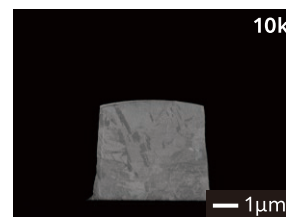
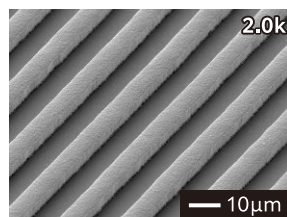
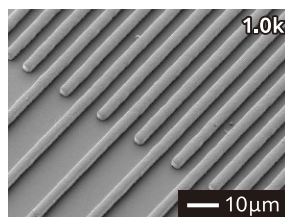
酸性脱脂

酸活性

硫酸銅めっき

熱処理

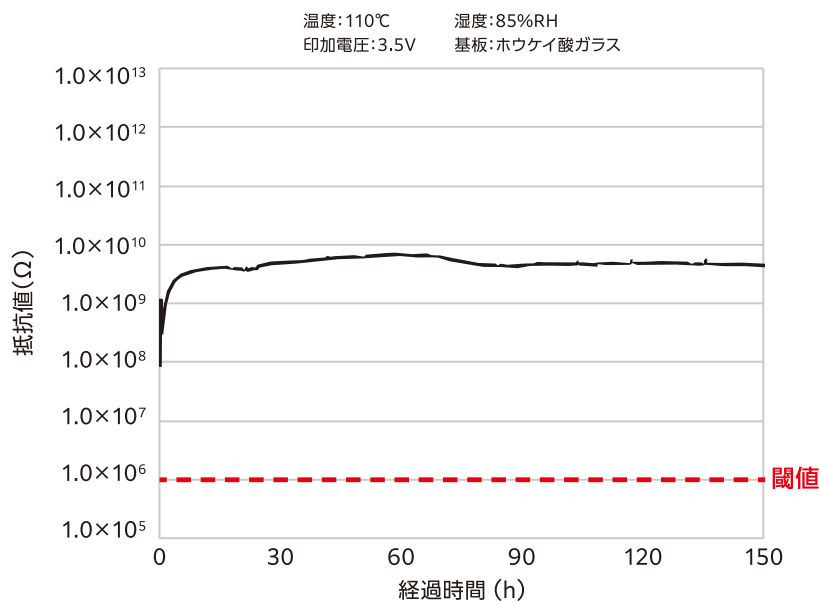
微細パターン形成が可能



表面SEM像(L/S=5/5μm)

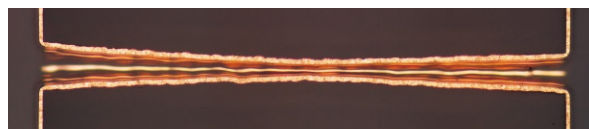
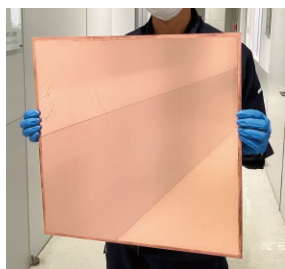
断面SEM像(L/S=5/5μm)

優れた耐マイグレーション性



HASTによる抵抗測定結果

良好なスルーホールめっきを実現



ガラス基板の大きさ: 510×515mm, 板厚: 800μm, 穴径: 75μm

大型の高アスペクト比スルーホールに対応